

证券代码：001270

证券简称：铖昌科技

浙江铖昌科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20240523

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与单位	新华资产、民生加银基金、恒生前海基金、中信证券、招商证券、金圆资产、国信投资、江苏瑞华、台州城投、探骊基金、萧恒资产。
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：赵小婷 证券事务代表：朱峻瑶
时间	2024年5月22日、2024年5月23日
地点	公司会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>一、问答环节</p> <p>1、公司毛利率有所波动，请介绍原因以及后续发展情况。</p> <p>答：毛利率的波动主要有两方面原因，一是公司产品结构发生变化，早期公司单个领域产品占公司营收较高，为了持续扩大规模，提升公司市场竞争地位，公司一直在不断扩展产品应用领域范围，并取得了可观进展。目前产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域，产品应用线逐渐丰富。综合毛利率虽有一定的波动，但随着多个领域需求量的扩大，总体将趋于稳定。</p> <p>另一方面，随着相控阵系统技术的进一步发展、成熟，</p>

在下游多领域份额逐步提升，其成本也在进一步降低，因此下游行业价格体系有所变化。随着其需求量在不断提高，有利于公司进行降本增效，继续推进 T/R 芯片在多领域多系列装备中的大规模应用。

2、公司一直注重拓展领域，目前的产品结构如何？

答：公司在星载领域继续保持领先优势，遥感、通信等多个卫星项目按计划进行；同时地面领域产品品类不断拓宽，各类型、不同应用场景的雷达配套 T/R 芯片有着持续的量产需求，2021 年至 2023 年收入规模持续增长，地面领域已经成长为了营收中的重要组成部分。

另外公司前期布局的多个项目中，机载领域配套产品自 2023 年的小批阶段陆续进入批产阶段，机载领域作为公司发展的重点领域之一，成为公司新的增长点。公司将继续拓展下游应用领域，扩大产品在多领域的市场份额。

3、公司研发人员增幅较高，具体情况如何？

答：截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 99 人，占公司人员总数比例为 47.60%，相比上年同期增长 32%。其中，博士及以上学历 7 人，硕士学历 32 人，硕士及以上学历约占技术团队总人数的 39.39%。公司一直注重引进和培养优秀人才，也是公司持续提高核心竞争力的基础。公司主要的核心技术人员均参与员工持股平台、限制性股票激励计划，让研发人员在与公司共同发展中分享收益，提高研发人员的积极性和主动性。

4、公司发布了限制性股票激励计划相关公告，现在的进度如何？

答：公司实施 2024 年限制性股票激励计划旨在吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才，从而有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。本计划考核年度为 2024、

2025、2026年三个会计年度，考核指标为对应考核年度相比上一年度的营业收入增长率，股权激励首次授予总量为377万股，参与人员达到总人数的45%，覆盖公司各部门的核心骨干人员，让员工在与公司共同发展中分享收益，全面提高员工的工作积极性。目前公司还在积极办理授予的相关手续，后续有进展会及时公告。

5、请问公司在低空经济方向是否有相关布局 and 规划？

答：公司在产业链中属于三、四级配套商，较为前端。客户以科研院所及下属单位居多，目前产品主要批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域。公司将持续关注下游领域相关技术创新及应用等情况，并结合自身实际情况，积极拓展符合公司发展规划的业务。

6、公司所处行业的竞争格局如何？

答：公司产品T/R芯片作为相控阵雷达系统的重要组成部分之一，具有较高的技术经验壁垒，资质门槛也相对较高，目前国内具有T/R芯片研发和量产的单位主要为科研院所以及少数具备三、四级配套能力的民营企业，科研院所及其下属单位所占市场份额较高。公司作为国内少数能够提供T/R芯片完整解决方案的企业之一，已系统性掌握T/R芯片的核心技术，并建立起完整的科研、生产销售、供应链及人才培养等体系能力，公司将继续加大研发投入和新产品开发，不断拓展产品应用，在相关领域内保持有利地位。

7、公司进入低轨卫星通信领域较早，进展情况如何？

答：在卫星通信领域方面，公司具备先发优势，已进入主要客户核心供应商名录，近两年已进入量产阶段并在按计划持续交付中，成为公司营收组成部分之一。

	<p>公司紧跟行业发展趋势，与科研院所及相关优势企业合作关系紧密，持续进行卫星通信 T/R 芯片解决方案的迭代研制，围绕低轨卫星通信相控阵天线高性能、低成本、小型化的需求，重点研制高集成度、轻量化、多功能化、多波束、低功耗 MMIC 系列产品，为下游客户提供高可靠、高性能的低成本产品，为进一步扩大市场份额进行相关储备。</p> <p>8、公司目前产品的工艺情况如何，有什么优势？公司在材料工艺上有什么新的布局吗？</p> <p>答：公司功率放大器芯片主要采用 GaAs、GaN 工艺，具有宽禁带、高电子迁移率、高压高功率密度的优势，研制多种频段的功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、收发多功能芯片，具备高性能、高集成度和高可靠性等特点。对于幅相控制类芯片，公司研制的产品采用 GaAs 和硅基两种工艺，分别具备不同的技术特点，可适应于客户的各类应用场景，其中 GaAs 工艺芯片产品在功率容量、功率附加效率、噪声系数等指标上具备优势，硅基工艺芯片产品则在集成度、低功耗和量产低成本方面具备显著优势。</p> <p>相控阵体制的无线电子信息系统为当前及未来先进无线系统的主流发展方向，公司将持续专注于主营业务发展，不断拓展产品应用领域。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为</p>	<p>无</p>

附件)	
-----	--